【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】令和6年9月5日(2024.9.5)

【国際公開番号】WO2024/069983
【出願番号】特願2023-570046(P2023-570046)
【国際特許分類】
Ｂ２３Ｋ 35/30(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２３Ｋ 35/30 ３２０Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和5年11月10日(2023.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
サブマージアーク溶接用のソリッドワイヤであって、前記ソリッドワイヤの全質量に対する質量％で、前記ソリッドワイヤの化学成分が、
Ｃ　：０～０．６５０％、
Ｓｉ：０．０３～０．５０％、
Ｍｎ：４．１～３０．０％、
Ｐ　：０～０．０５０％、
Ｓ　：０～０．０５０％、
Ｃｕ：０～５．０％、
Ｎｉ：１．０～３０．０％、
Ｃｒ：０～１０．０％、
Ｍｏ：０～１０．０％、
Ｎｂ：０～１．００％、
Ｖ　：０～１．００％、
Ｃｏ：０～１．００％、
Ｐｂ：０～１．００％、
Ｓｎ：０～１．００％、
Ａｌ：０～０．１０％、
Ｔｉ：０～０．１０％、
Ｂ：０～０．１０００％、
Ｎ　：０～０．５００％、
Ｏ　：０～０．００５０％、並びに
残部：Ｆｅ及び不純物であり、
かつ前記Ｍｎ含有量及び前記Ｎｉ含有量の合計（Ｍｎ＋Ｎｉ）が５．０％以上であり、
前記Ｍｎ含有量、前記Ｎｉ含有量及び前記Ｃｒ含有量の合計（Ｍｎ＋Ｎｉ＋Ｃｒ）が１５．０％以上であり、
磁気誘導法により求められるｆｃｃ割合が７０％以上であり、
前記Ｍｎ含有量と前記Ｎｉ含有量との質量比（Ｎｉ／Ｍｎ）が０．６８以上であるソリッドワイヤ。
【請求項２】
前記質量比（Ｎｉ／Ｍｎ）が、１．００以上である請求項１に記載のソリッドワイヤ。

【請求項３】
前記Ｔｉの含有量が、Ｔｉ：０．００３～０．１０％である請求項１に記載のソリッドワイヤ。
【請求項４】
請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のソリッドワイヤを用いて、鋼材をサブマージアーク溶接する工程を備える溶接継手の製造方法。